

Call for Abstracts

Deutsche IMAPS Konferenz in München - Oktober 2021

IMAPS Deutschland möchte zur Jahreskonferenz 2021 nach München einladen.

Die Herbstkonferenz der IMAPS wird von allen Teilnehmern als eine wichtige Plattform für fachliche Diskussionen zwischen Industrie und Hochschule sowie Produktion und Forschung verstanden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu stärken und voranzubringen. In Zeiten der Corona-Pandemie warten und hoffen die Meisten wieder auf die Möglichkeiten für ein persönliches Treffen.

Wir - die IMAPS Deutschland – möchten Sie darin bestärken und planen unsere diesjährige Herbstkonferenz 2021 zum jetzigen Zeitpunkt als Präsenzveranstaltung.

Wir laden Sie deshalb in diesem Jahr wieder herzlich ein, Ihre Ergebnisse zu den nachfolgend genannten Themen auf dem Gebiet des mikroelektronischen Packaging auf unserer Tagung vor Vertretern aus Industrie und Wissenschaft zu präsentieren und gemeinsam zu diskutieren (Vortragsdauer 15-20 min, keine Paper nur Präsentation). Mit einem halben Jahr Vorausschau haben wir derzeit noch die Hoffnung, den bewährten Mix aus fachlichem Austausch, persönlichem Gegenüber, Ausstellung, Vortragsreihen und Festigung von Netzwerken wieder in angemessener und vertretbarer Weise aufnehmen zu können.

Sollte die Konferenz aus gegebenem Anlass nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden können, werden wir die Veranstaltung virtuell abhalten, was Ihnen die Möglichkeit gibt, auch auf diesem Wege Ihre Ergebnisse zu präsentieren. Bitte senden Sie Ihren Abstract **bis zum 15. Juli** zur Bewertung ein (ca. 200 Wörter). Nutzen Sie für die Einreichung bitte folgenden Link:
<https://www.conftool.net/imaps-herbsttaugung-2021>



(Freischaltung ab 20.Mai 2021)

Themen und Schwerpunkte der IMAPS Konferenz

Entwurf, Modellierung, Simulation	Materialien und Prozesse
<ul style="list-style-type: none">• Elektrisches und elektromagnetisches Design• Thermisches und thermomechanisches Design• Fertigungs- und testgerechtes Design• HF-Design und 3D-Entwurf	<ul style="list-style-type: none">• Substratmaterialien und Oberflächenschichtsysteme• Herstellung von Verdrahtungsträgern• Verbindungstechnologien (Flip Chip, CoB, SMT, Embedding, ...)• Prozesse und Materialien für Schutz, Verguss und Verkapselung• Nanomaterialien
Technologien der Systemintegration	Qualität und Zuverlässigkeit
<ul style="list-style-type: none">• Wafer Level Packaging (CSP, SiP, ...)• Substrate Level Packaging (System on Board, Embedding, ...)• MEMS / Sensor-Packaging• Optoelektronisches Packaging• 3D-Packaging	<ul style="list-style-type: none">• Prozessüberwachung / Teststrategien• Prüfsysteme• Thermomechanische Zuverlässigkeit• Zuverlässigkeit bei kombinierten Beanspruchungen• Lebensdauermonitoring und -vorhersage

Wir vergeben auch dieses Jahr ein Best Presentation Award!

(Dies gilt nur für die Präsenzveranstaltung!)